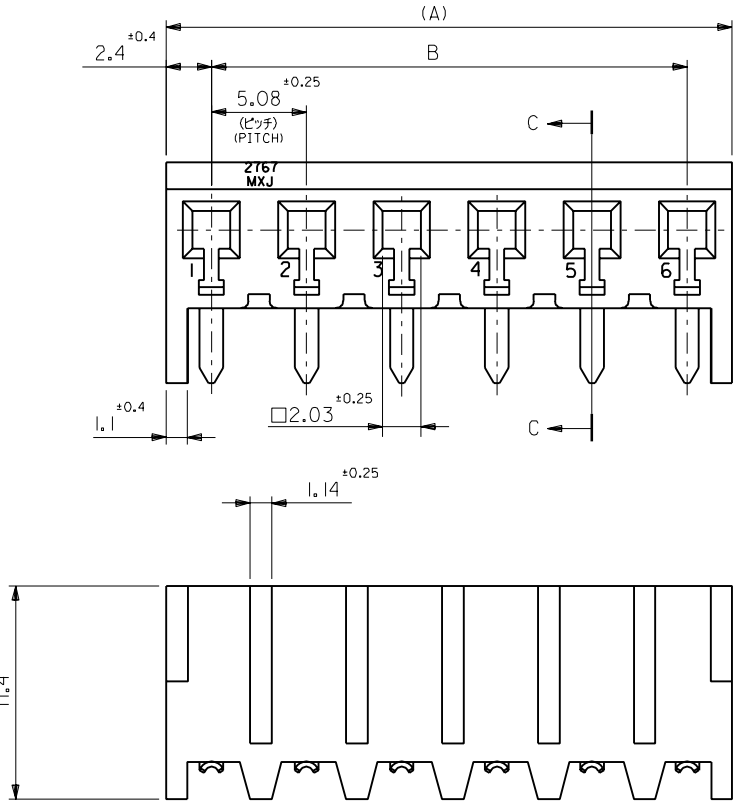
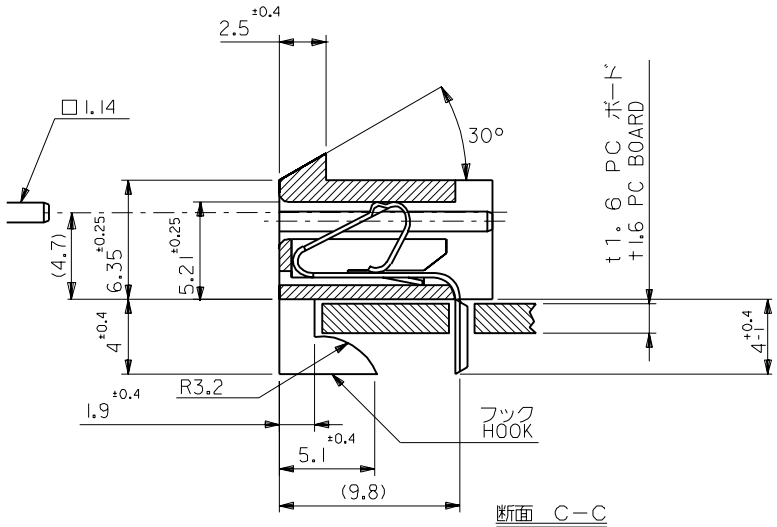
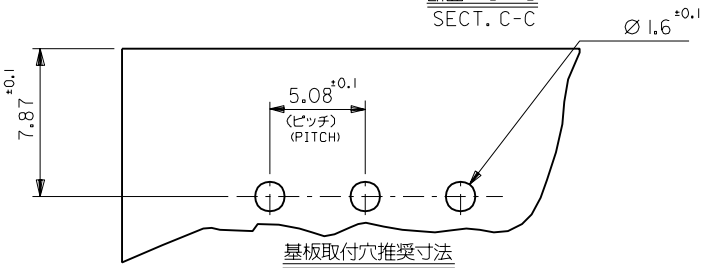
DWG. NO. SD-2767-NAH





断面 C−C
SECT. C-C



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

注：( ) 内寸法は参考値
NOTE:( ) DIMENSION IS FOR REFERENCE

25.4 ±0.2	30.2	10-05-1063	2767-6AH	6
20.32 ±0.2	25.12	10-05-1053	2767-5AH	5
15.24 ±0.15	20.04	10-05-1043	2767-4AH	4
10.16 ±0.15	14.96	10-05-1033	2767-3AH	3
5.08 ±0.15	9.88	10-05-1023	2767-2AH	2
B	(A)	EDP.NO.	ENG.NO.	極数 NO. OF CKTS

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
C	再作図 REDRAWN (JC70307)	n.j M.F	96/05/23

材料 ターミナル：黄銅、錫下付錫メッキ
MATERIAL TERMINAL:BRASS, TIN OVER COPPER PLATING
ハウジング：ナイロン66、94V−2
HOUSING:NYLON66,94V-2

仕上げ FINISH —#—

適用電線範囲 WIRE RANGE —#—

被覆外径 INS. RANGE —#—

DRAWN BY '96/05/23 H.IIJIMA
CHK'D BY '96/05/23 M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/05/23 M.ENOMOTO
尺度 SCALE 4 : 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
KK 5.08 RECEPTACLE HSG.ASS'Y

DWG. NO. SD-2767-NAH
REV C

2767.S20

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32